

材料与化学学院
材料成型及控制工程（芯片与增材制造方向）
2025级辅修专业培养计划

一、培养要求

培养跨专业、复合型卓越工程人才，毕业生掌握 AI 智能制造、芯片制造、增材制造（3D 打印）的专门知识和技能，具有分析和解决多学科交叉问题的能力，能够胜任主修专业和 AI 智能制造领域复合交叉的设计、研发、管理、创新工作。

二、毕业要求

掌握先进材料知识，具有计算机辅助设计制造与分析的能力，掌握智能制造、芯片制造、增材制造（3D打印）的专门知识和实践技能。能够结合主修专业，解决复合交叉学科和工程领域的复杂问题。

修满培养方案规定的38个课程学分准予毕业，完成毕业设计并满足学位授予条件的授予学位。

三、学制与授予学位

计划学制2.5年，授予学位：工学。

四、招生对象与报名条件

1. 全日制在校二年级本科生；
2. 课程成绩累计平均绩点达到2.50及以上；
3. 主修专业非材料类（材料科学与工程、材料成型及控制工程）。

五、课程设置与学分分布

总计38学分，其中学科基础课程10学分，核心课程14学分，毕业设计14学分。

序号	课程代码	课程名称	总学时	学分	考核方式	授课学期
1	26000930	材料科学基础A	48	3	考试	第四学期
2	26001020	材料工程基础A	48	3	考试	第四学期
3	28000112	半导体材料	32	2	考查	第五学期
4	28000104	增材制造材料	32	2	考查	第五学期
5	26000070	材料加工 CAD/CAM	48	3	考查	第五学期
6	26001170	成型制造智能仿真	48	3	考查	第六学期

7	26001110	增材制造技术	32	2	考查	第六学期
8	26001130	微纳制造技术	32	2	考查	第六学期
9	26100570	增材制造项目实践	64	2	考查	第七学期
10	26100510	微纳制造项目实践	64	2	考查	第七学期
11	26100052	毕业设计	14周	14	考查	第八学期